



台光電子材料股份有限公司

全球環保暨高階基材的領航者

法人說明會簡報

115年4月

*Innovation
Globalization
Diversification*



免責聲明

本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。

因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。

本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

會議議程

01	第一季營運成果	04
02	領先同業持續擴大	07
03	台光電成長優勢 • 技術 • 規模 / 生產據點分散	09
04	問答時段	13

第一季綜合損益表

綜合損益表項目
(新台幣百萬元)

	1Q26	4Q25	1Q25	季變化	年變化
營業收入	33,067	24,927	21,680	32.7%	52.5%
營業毛利	9,729	7,125	6,590	36.5%	47.6%
營業利益	7,128	4,935	4,540	44.4%	57.0%
繼續營業部門稅前淨利	7,194	4,620	4,667	55.7%	54.1%
所得稅費用	-1,855	-884	-1200	109.8%	54.6%
稅後淨利	5,339	3,736	3,467	42.9%	54.0%
基本每股盈餘(新台幣元)	14.90	10.44	10.01	42.7%	48.9%
營業毛利率(%)	29.4%	28.6%	30.4%	0.8%	-1.0%
營業利益率(%)	21.6%	19.8%	20.9%	1.8%	0.7%
稅後淨利率(%)	16.2%	15.0%	16.0%	1.2%	0.2%
股東權益報酬率	43.4%	31.5%	40.6%		

第一季資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣百萬元)

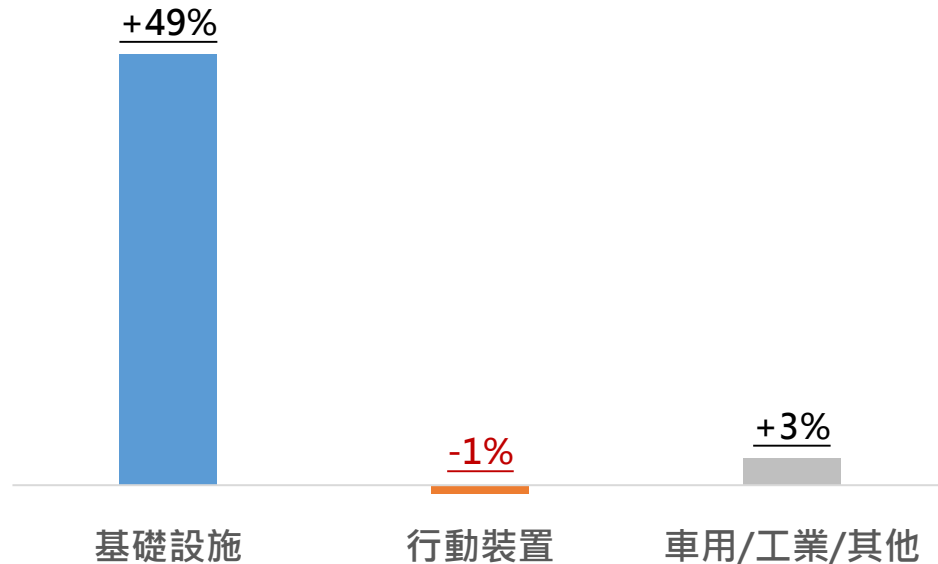
	1Q26		4Q25		1Q25	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	22,135	16.9%	20,008	18.5%	18,427	21.1%
應收帳款+應收票據	46,480	35.5%	36,115	33.5%	30,239	34.6%
存貨	21,016	16.1%	16,752	15.5%	10,558	12.1%
不動產、廠房及設備	37,110	28.3%	30,864	28.6%	23,842	27.3%
資產總計	130,977	100.0%	107,913	100.0%	87,415	100.0%
短期借款	13,572	10.4%	11,264	10.4%	9,040	10.3%
應付帳款	31,382	24.0%	24,518	22.7%	18,053	20.7%
長期借款	10,979	8.4%	8,219	7.6%	11,385	13.0%
業主權益	47,921	36.6%	50,435	46.7%	33,272	38.1%
負債及權益	130,977	100.0%	107,913	100.0%	87,415	100.0%
重要財務指標						
平均收現日數	114		133		118	
平均銷貨日數	74		79		61	
流動比率 (倍)	1.3		1.6		1.5	

第一季銷售分析-產品組合

基礎設施的強勁增長反映高端材料市佔率提升

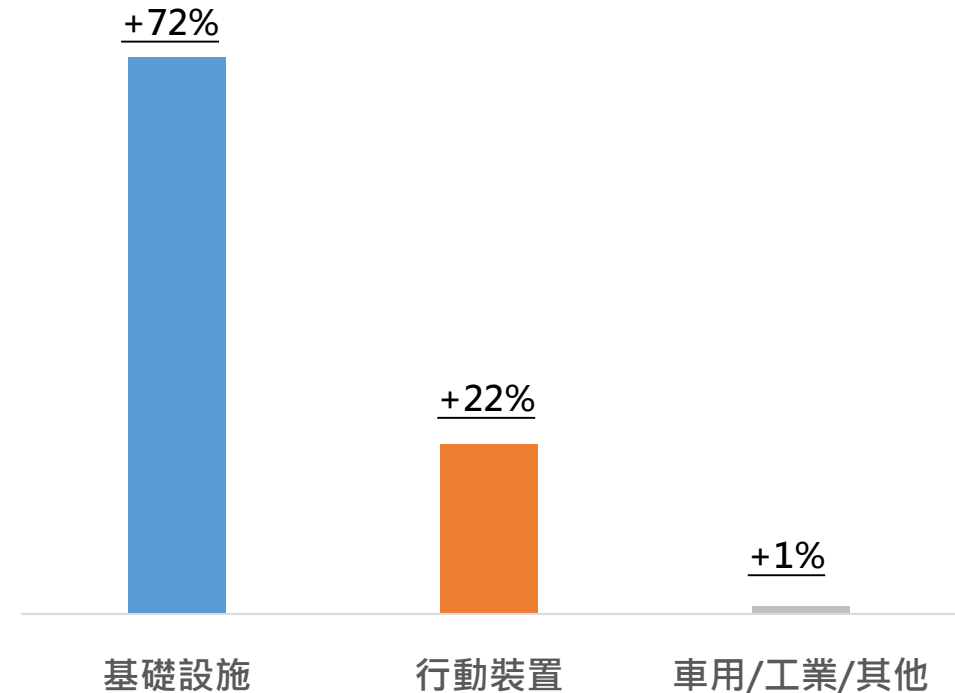
第一季營收成長：33% QoQ

季變化



第一季營收成長：53% YoY

年變化

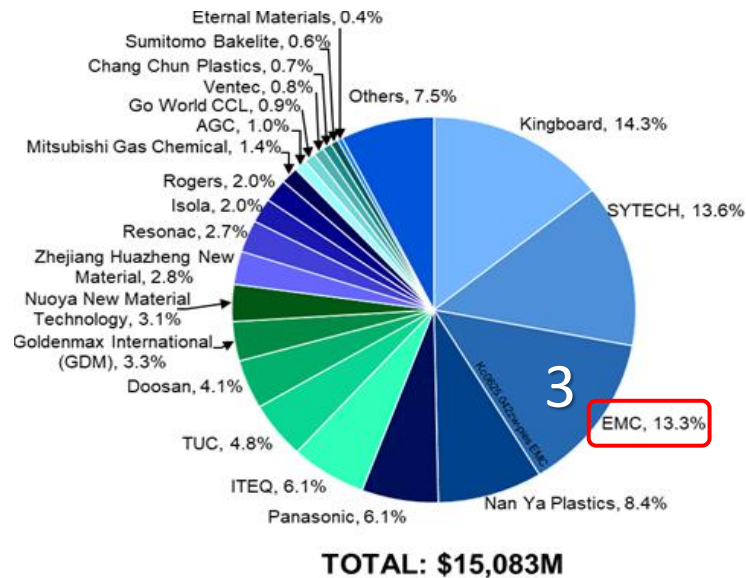


領先同業持續擴大

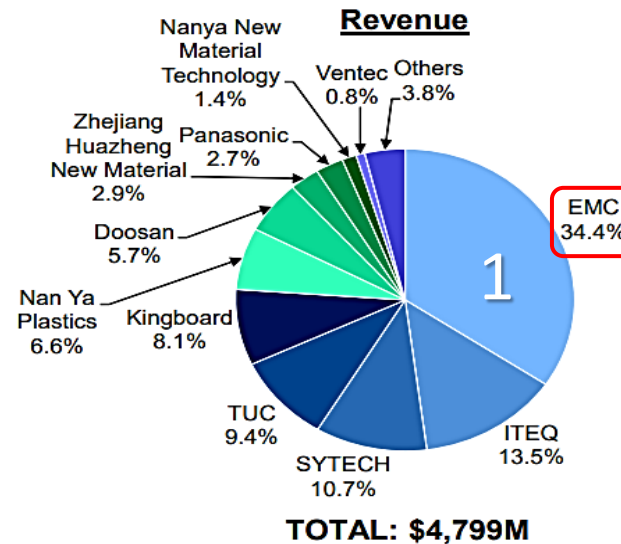
高階市場市佔擴大領先

- Global **No. 1** – mSAP, HDI Laminate provider
- Global **No. 1** – High-Speed Green Laminate provider

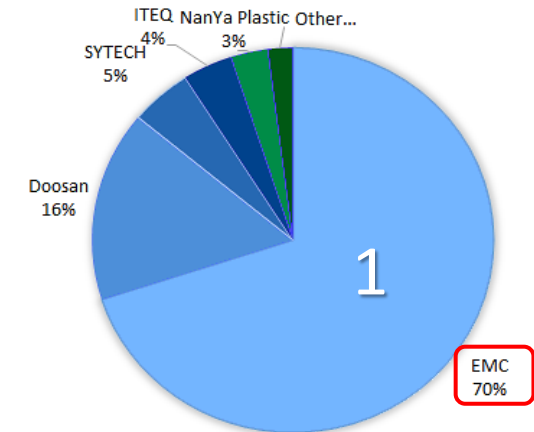
Laminate Market



Green Laminate Market



HDI Laminate Market

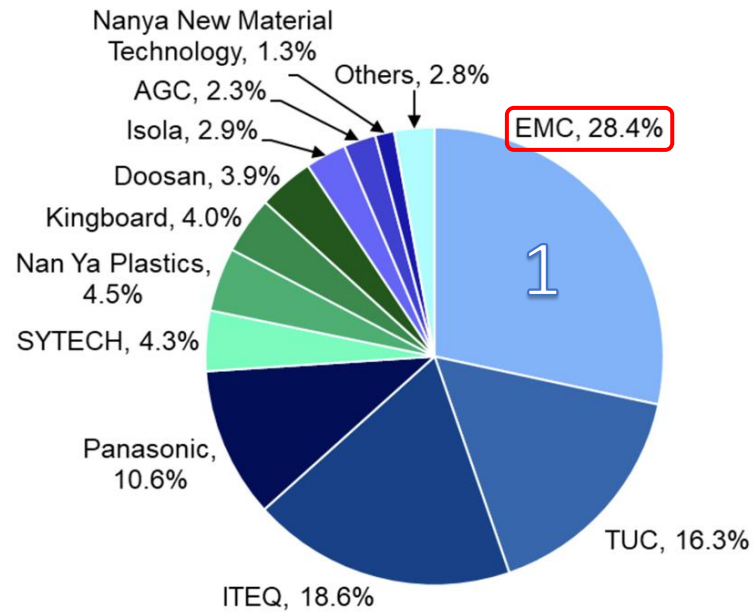


- By Revenue
- Mass Lam Sales is excluded.

領先同業持續擴大

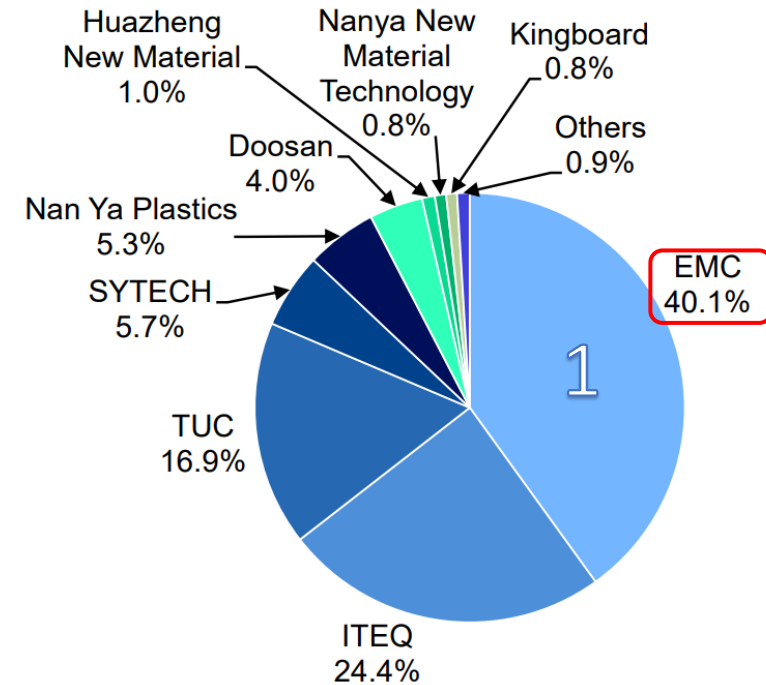
2023 年高速材料全球排名第一，且市佔率持續成長中

2023



(Standard + Halogen-Free) High-Speed Laminate

2024

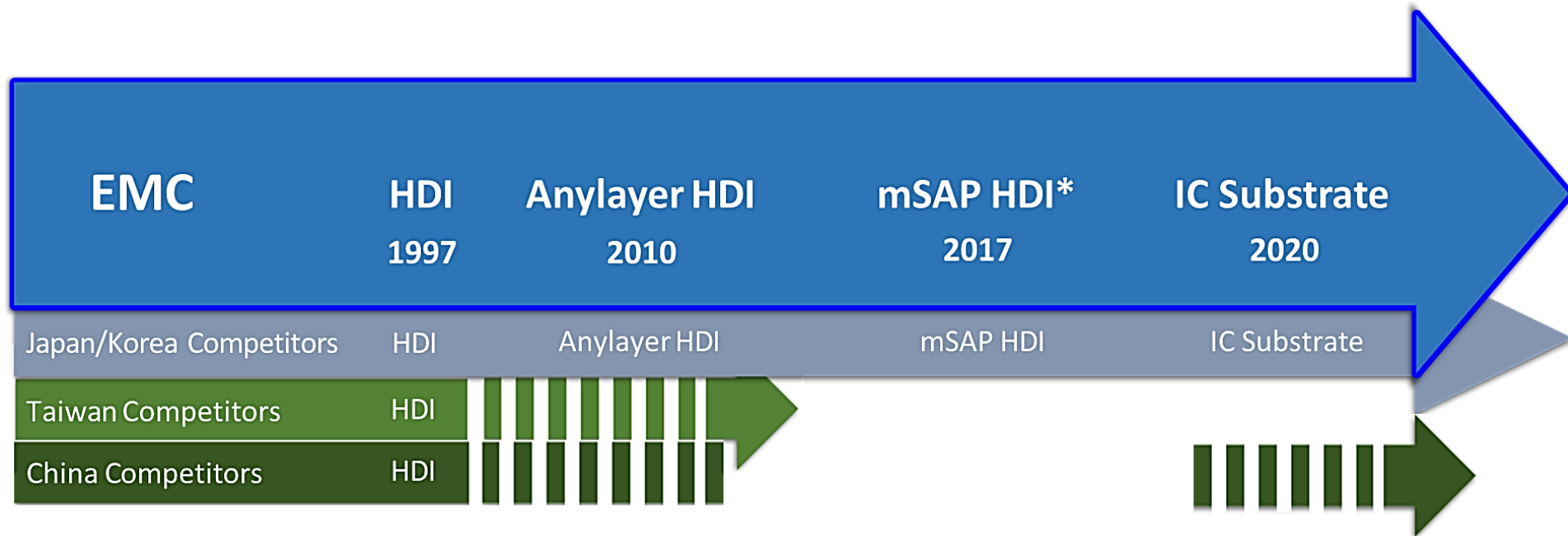


(Halogen-Free) High-Speed Laminate Only

台光電成長優勢

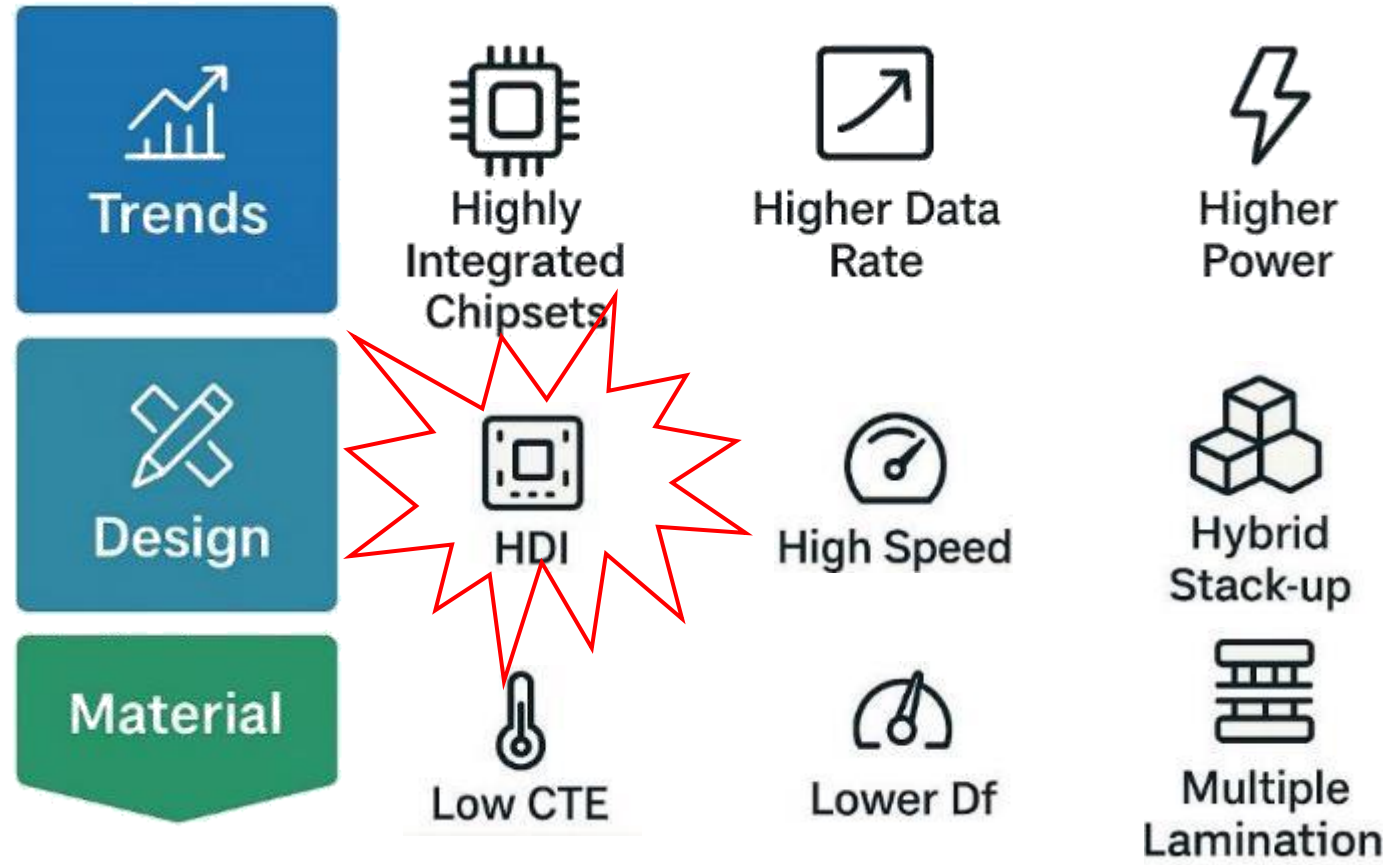
HDI 技術領先

The only mSAP and substrate maker outside Japan/Korea with 100% proprietary technology



台光電成長優勢

AI 基礎設施設計趨勢 HDI 廣泛應用到 High Speed



台光電成長優勢

規模及全球佈局

California, US



ARLON
ELECTRONIC MATERIALS

EMC: the only Asian CCL Supplier
with US Sales & Production Presence

廠區產能

基板 (張/月)

Total (2024)		4.35 M
Huangshi	(CN)	0.30 M
Penang	(MY)	0.60 M
Zhongshan	(CN)	0.60 M
Total (2025)		5.85 M
Guanyin	(TW)	0.30 M
Total (2026)		6.15 M
Kunshan	(CN)	0.60 M
Zhongshan	(CN)	0.60 M
Kunshan	(CN)	0.60 M
Zhongshan	(CN)	0.60 M
Guanyin	(TW)	0.75 M
Penang	(MY)	0.15 M
Total (2027)		9.45 M

Huangshi, China



300K shts/mon
Q2 2025

Kunshan, China



600K shts/mon
Q1 2027

600K shts/mon
Q3 2027

Guanyin, Taiwan



300K shts/mon
Q4 2026

750K shts/mon
Q4 2027

Zhongshan, China



600K shts/mon
Q1 2027

600K shts/mon
Q3 2027

Penang, Malaysia



600K shts/mon
Q3 2025

150K shts/mon
Q4 2027

EMC: Dominant CCL Capacity in Southeast Asia
(Competitors provide less capacities or incomplete
production capabilities)

永續報告

公司治理評鑑提升至前 6 - 20%

以2023年為基準年，2030年達成減碳30%



Q & A